



深圳市吉宸电子有限公司

Shenzhen Ji Chen Electronics Co.,Ltd



KM1210HK-J182

KM1210HK-J182

低温固化高导银胶

产品描述:

KM1210HK-J182 产品是一种单组份低温固化环氧导电银胶。它具有高剪切强度，模量的特点；对金属、陶瓷基片、硅芯片、绿油等粘接性好。该产品具有极好的贮存特性，固化温度较低，离子杂质含量低，固化物良好的电学和机械性能以及耐湿热稳定性能优点。

典型用途:

该产品广泛应用于 VCM 摄像头模组、PCB 板、FPC、集成电路等一些基材或工艺不能承受高温烘烤的导电连接。适用于点胶、蘸胶作业工艺，能实现低温快速固化，连接强度高。

技术指标:

KM12010HK-J182	项目	测试方法	性能指标
固化前性能	粘度 @25°C (Brookfield DV-II+CP@ 5prm)	ASTM D1084-97	KM12010HK-J182 32,000 cP
	触变指数@ 25°C@(0.5rpm/5 rpm)	ASTM D1084-97	5.6
	细度, μm	0-50μm	<10
	含银量	By weight	87%
	使用寿命@ 25°C	-	9hour
	保质期	-	>6month @ -25°C
	固化条件	DSC, 10K/min	60min@ 90°C
固化后性能	体积电阻率 (Ω*cm)	ASTM-D2397	<0.0006
	剪切强度@ 25°C	ASTM-D412	> 26 Kg/die
	拉伸强度@ 25°C	ASTM-D412	> 2600 psi
	导热系数@ 121°C	ASTM-E1461	50 W/mK
	玻璃转变温度°C	DSC, 10K/min	80
	热膨胀系数<Tg	TMA	45ppm/°C
	热分解温度, °C	TG, 10K/min	>300
适用范围			摄像头模组、其它低温工艺
注意事项	<p>1.拆封: 收到冰袋包装的银胶后立刻将银胶转移到-25°C冰柜。</p> <p>2.贮存: 低温导电银胶的贮存温度应不高于-25°C。如果在此条件下贮存, 该产品达到半年内可使用。贮存期限指明必须有正确的贮存条件, 不当的贮存将可能造成点胶的困难和固化后银胶品质降低。</p> <p>3.解冻: 本产品在使用之前, 先将其回温至室温。在冰箱中取出后, 将针筒垂直地放置进行回温。解冻时间, 10 克针筒:60min;20 克针筒: 90 分钟; 50 克瓶装 120 分钟。在解冻时注意擦干外层包装的水分才能取出银胶, 取出的银胶需要搅拌均匀后才能正式使用。</p> <p>4. 使用: 回温后的胶必须立即放在点胶设备上加以使用。如果需要把胶转移到后期点胶器 里面, 要小心操作, 切忌在转移过程中带入杂质或空气。回温后的胶必须在 12 小时内全部使用完。超出工作小时后, 放置在室温下的胶会发生银粒子与树脂的 分离, 可能会造成胶性能不稳定。</p> <p>5. 运输: 在包装和运输过程中, 该产品放在-40°C的干冰中。请及时检查干冰的状态, 以 确保运输的可靠性。如果检查发现干冰已经融化, 请将所有的产品放在-40°C冰 箱中, 并与 Kmarked 客户服务或销售代表联系。</p> <p>6. 包装规格: 50cc (50g)、1000cc (1000g)</p>		

应用案例:

